

# SKC Investor Day 2023

- 1989 마그네틱 옵티컬 디스크 개발
- 1989 감열전사(TTR) 필름 개발
- 1988 폴리이미드 필름 개발
- 1984 3.5인치 플로피디스크 개발
- 1984 8MM 비디오테이프 개발
- 1982 5.25인치 플로피디스크 개발
- 1980 비디오테이프 세계 네 번째로 개발

**2009 세계 최초 PLA 필름 개발**

**2008 세계 최초 친환경 HPPO 공장 상업화**

- 1998 국내 최초 CD-RW 개발
- 1996 DVD 개발
- 1994 미니디스크(MD) 국내 최초 개발
- 1993 레이저디스크(LD) 국내 최초 생산
- 1991 국내 최초 PO/SM, PG 상업생산**
- 1990 그린하우스용 PET필름 개발

- 2022 세계최초 4680 배터리용 V동박 개발
- 2022 022 세계최초 DPG 단독공정 상업화
- 2022 세계최초 DPG 단독공정 상업화

**2022 국내 최초 친환경 RE-POYOL 기술 상용화**

**2021 세계최초 고성능 반도체 패키징 글라스 기판 상업화**

- 2021 실리콘 음극재 사업 투자 결정

**2021 생분해 LIMEX 기술 확보**

- 2020 동박 6 $\mu$ m 두께 77KM 권취 성공

- 2019 세계 최초 4 $\mu$ m 전지용 동박 개발

**2018 CMP PAD 국산화 및 고객 인증**

- 2018 세계 최초 PCT필름 상용화

**1970~1980**

**1977 국내 최초 PET 필름 개발**

- 1978 알루미늄 증착필름 개발
- 1979 스탬핑 포일 개발

**1990~2000**

**2010~2020**

- 2013 세계 최초 6 $\mu$ m 전지용 동박 양산

**2015 고강도-고연신 전지박 E전지박 개발**

- 2015 탄성패드 국내 첫 최초 고속철도용 엘라스토머 공급

**2016 EV용 6 $\mu$ m 고강도, 고연신 전지박 양산**

- 2016 고부가 폴리우레탄 'CMP 패드' 공장 준공

- 2017 폴더블 디스플레이 핵심소재 '투명PI 필름' 개발

- 2017 세계 최고 5 $\mu$ m 전지용 동박 개발

- 2017 2-METAL FCCL 인증 및 양산 개시

- 1989 마그네틱 옵티컬 디스크 개발
- 1989 감열전사(TTR) 필름 개발
- 1988 폴리이미드 필름 개발
- 1984 3.5인치 플로피디스크 개발
- 1984 8MM 비디오테이프 개발
- 1982 5.25인치 플로피디스크 개발
- 1980 비디오테이프 세계 네 번째로 개발

- 2009 세계 최초 PLA 필름 개발
- 2008 세계 최초 친환경 HPPO 공장 상업화
- 1998 국내 최초 CD-RW 개발
- 1996 DVD 개발
- 1994 미니디스크(MD) 국내 최초 개발
- 1993 레이저디스크(LD) 국내 최초 생산
- 1991 국내 최초 PO/SM, PG 상업생산
- 1990 그린하우스용 PET필름 개발

- 2022 세계최초 4680 배터리용 V동박 개발
- 2022 세계최초 DPG 단독공정 상업화
- 2022 세계최초 DPG 단독공정 상업화
- 2022 국내 최초 친환경 RE-POYOL 기술 상용화
- 2021 세계최초 고성능 반도체 패키징 글라스 기판 상업화
- 2021 실리콘 음극재 사업 투자 결정
- 2021 생분해 LIMEX 기술 확보
- 2020 동박 6 $\mu$ m 두께 77KM 권취 성공
- 2019 세계 최초 4 $\mu$ m 전지용 동박 개발
- 2018 CMP PAD 국산화 및 고객 인증
- 2018 세계 최초 PCT필름 상용화

## 1970~1980

- 1977 국내 최초 PET 필름 개발
- 1978 알루미늄 증착필름 개발
- 1979 스탬핑 포일 개발

## 1990~2000

## 2010~2020

- 2013 세계 최초 6 $\mu$ m 전지용 동박 양산
- 2015 고강도-고연신 전지박 E전지박 개발
- 2015 탄성패드 국내 첫 최초 고속철도용 엘라스토머 공급
- 2016 EV용 6 $\mu$ m 고강도, 고연신 전지박 양산
- 2016 고부가 폴리우레탄 'CMP 패드' 공장 준공
- 2017 폴더블 디스플레이 핵심소재 '투명PI 필름' 개발
- 2017 세계 최고 5 $\mu$ m 전지용 동박 개발
- 2017 2-METAL FCCL 인증 및 양산 개시

## 주력 사업

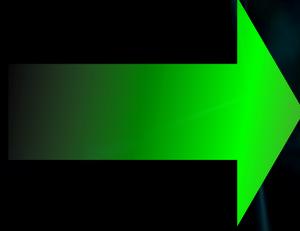
동박  
글라스기판  
생분해 소재  
CMP Pad



확장  
양산공장 건설

## 기존 사업

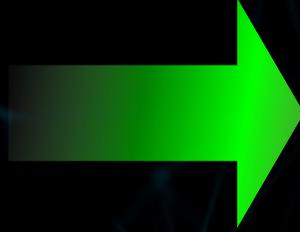
Film  
화학  
기타 저마진 사업



자산유동화

## 신규 사업

실리콘음극재  
Blankmask



사업검증 → 양산투자



2차전지, 반도체, 친환경 소재 분야에서  
Globalization 과 초격차 기술 우위를 통해  
고객에게 차별적 제품과 솔루션을 제공하는

## Global ESG 소재 Solution 기업

- ✔ 과감한 Portfolio In & Out을 통하여 지속가능한 성장을 추구한다
- ✔ 고객의 확장에 맞춰서 가격과 품질 측면에서 최적의 솔루션을 제공한다.
- ✔ 소재 R&D역량을 확장하여 미래 사업을 끊임없이 개발한다
- ✔ 창출 현금은 성장 재투자에 우선으로 활용한다
- ✔ ESG를 기반으로 모든 경영활동을 수행한다.

# 이차전지 소재



반도체 소재

친환경 소재



# 이차전지 소재

● 전체 (글로벌)

● 광폭 (중국제외)



Over-Supply



2023

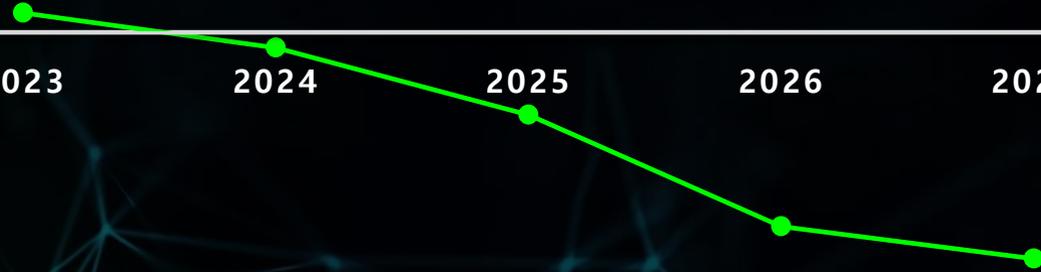
2024

2025

2026

2027

Shortage



## 제품 기술력

제품다양성

광폭 수율

극박

장조장

특허

## 원가 경쟁력

\$/ton

**Korea**

**Malaysia**

**Poland**

**N.America**

수출, 생산성



동정련 기술



차세대 장비



차세대 공정



# Global Capacity 250k ton

N.America

Poland

Malaysia

Korea

공급자 우위 시장 조성

고객사 *Commitment* 기반

IRA / Incentive 환경 고려

## 실리콘 음극재

저함량  
파일럿 투자

글로벌 OEM사  
테스트

고함량  
JV 추진

반도체 소재



이차전지 소재

친환경 소재



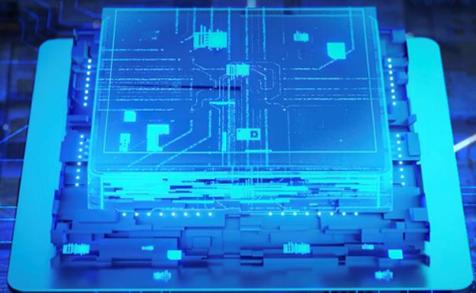
반도체  
소재

absolics

HPC 패키징 게임체인저

'24년 SVM 상업화 → HVM

효율적 Capex (CHIPS Act)



absolics



**위치 : 조지아주 Covington**

**규모 : 12,000m<sup>2</sup>**

**준공 : '23.12월**

이차전지 소재

반도체 소재

친환경 소재





## PBAT

고강도/성형성 우수



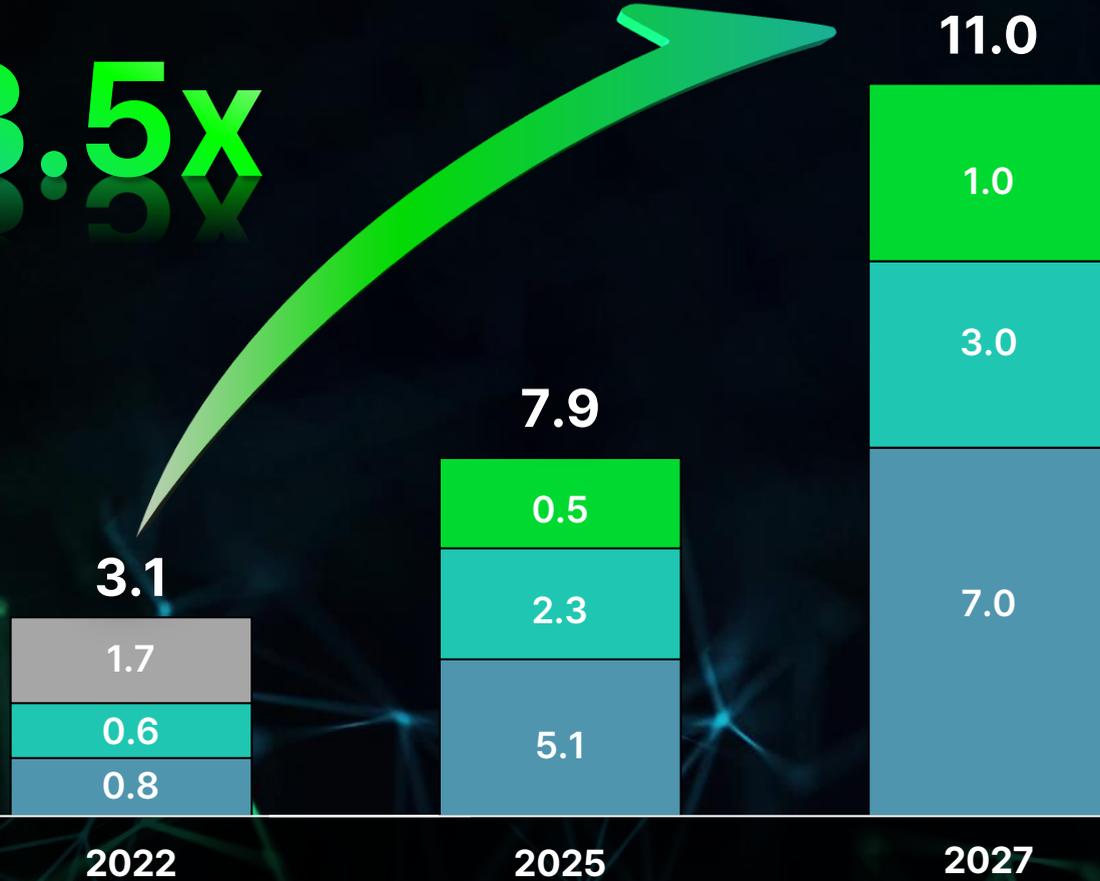
## 생분해 LIMEX

Cost Effective  
생분해 플라스틱

# Financial Target : 매출

3.5x

- 친환경
- 반도체
- 2차전지
- 화학



# Financial Target : 투자(~2027)

## 조달 자원 10조 이상

### CAPEX 5~6조

**1~2조**

신규 M&A

**4조**

Global 확장/증설  
및 신사업 투자

**0.2조**

친환경

**2.0조**

반도체

**1.8조**

이차전지

**4조+α**

영업현금창출

**1.2조**

정부보조금

**1.4조**

정책금융 등

**1.8조**

자산유동화

**1.4조**

현금성자산



# 변화에 성장을 입히다